

Assemblage électronique

Adhésifs, revêtements, résines de masquage et agents d'encapsulation polymérisables sous UV pour assemblage électronique

Our Technology. Your Advantage.®



Chez Dymax, nous combinons notre offre de produits avec nos connaissances expertes en technologie de photopolymérisation. Là où d'autres ne font que fournir des produits, nous nous engageons à développer un vrai partenariat en apportant notre expertise inégalée en matière de technologie de photopolymérisation ainsi que des connaissances complètes en fonction des problèmes spécifiques de nos clients.

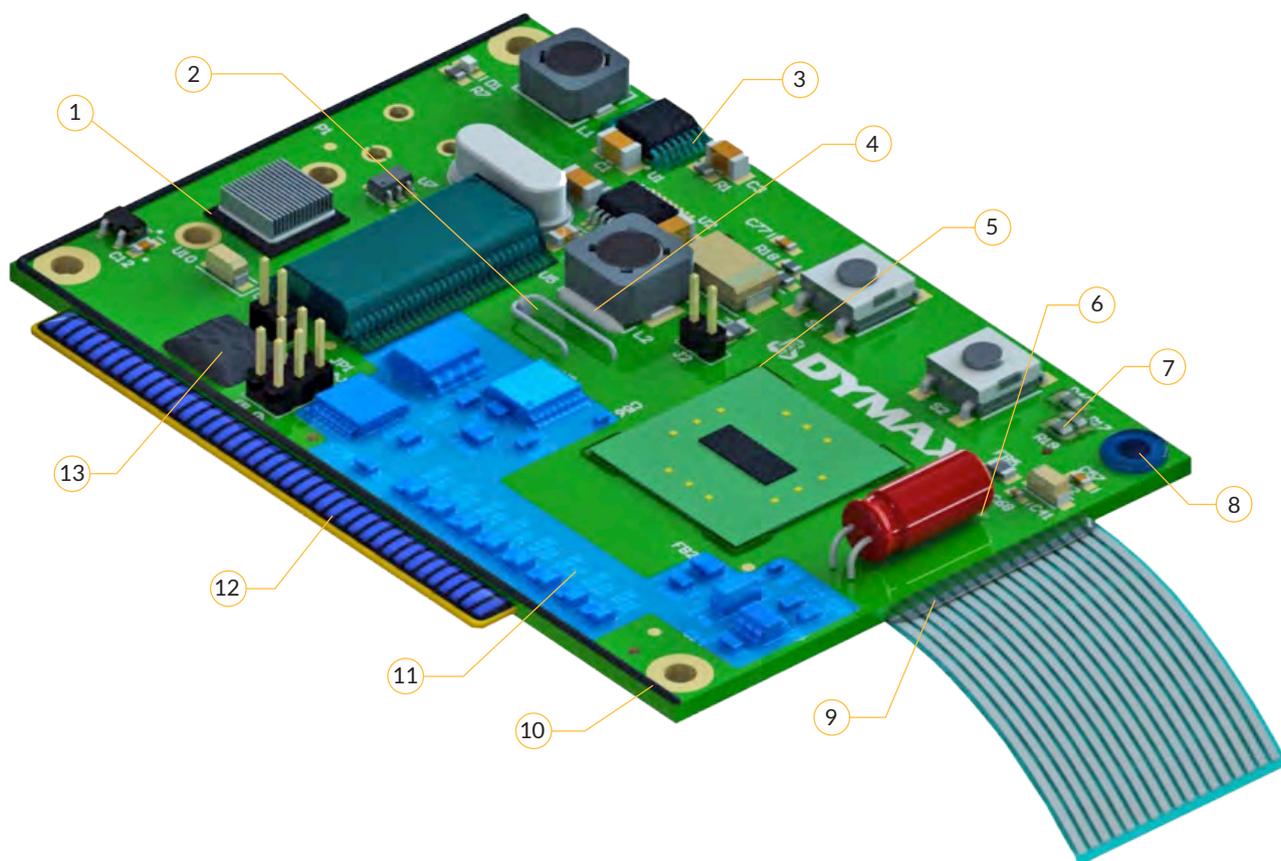
Parce que nous comprenons le processus dans son ensemble, nous pouvons offrir à nos clients une solution dans laquelle la chimie et les matériels fonctionnent ensemble sans heurts et avec un maximum d'efficacité. Notre équipe d'ingénieurs applications travaille aux côtés de nos clients en les aidant avec les produits et la conception de procédés, le choix et l'intégration de matériel, les tests, les évaluations et les essais avant production, et ce tout au long de la durée du processus d'assemblage. Notre laboratoire est parfaitement équipé pour la conduite de tests mécaniques sous diverses conditions d'environnement, notamment la force de cisaillement, la force d'adhésion entre substrats, le jeu de compression et le vieillissement à l'humidité selon les normes ASTM. Le laboratoire dispose aussi d'une palette de dispositifs de séchage et de systèmes manuels et automatiques de distribution pour évaluation.

Nos solutions d'assemblage et notre expertise apportent aux fabricants le savoir et les outils permettant d'accroître la productivité, de réduire les coûts, d'améliorer la sécurité et de rendre le processus de fabrication plus efficace. C'est un avantage concurrentiel qu'ils ne trouveront pas ailleurs.

Matériaux photopolymérisables Dymax

pour assemblage électronique

Dymax offre une vaste gamme de matériaux photopolymérisables pour utilisation dans des applications de protection des circuits et de montage électronique. Ces matériaux séchent en quelques secondes pour un traitement plus rapide et un débit plus élevé, et sont disponibles avec de nombreuses technologies innovantes et brevetées qui font tout simplement disparaître les problèmes tels que les zones ombrées, la confirmation de la polymérisation et l'inspection. Ces matériaux sont des isolants électriques, ce qui les rend idéaux pour le revêtement conforme, l'encapsulation, le liage, la gestion thermique, le masquage et bien d'autres procédés d'assemblage électronique. Les matériaux photopolymérisables Dymax sont aussi sans solvant et prêts à l'emploi, ils ne requièrent ni mélange ni préparation avant application. La plupart des produits sont disponibles selon des niveaux à viscosité multiple de sorte que le flux de matière puisse être adapté à une application en particulier. Des classes auto-extinguibles approuvées par l'IPC, MIL-I-46058C et homologués par UL sont disponibles.



- | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Interface thermique | 5. Renforcement/collage d'angles | 8. Masquage | 11. Revêtement conforme |
| 2. Fixation de filage | 6. Renforcement | 9. Réduction de tension | 12. Masque pelable |
| 3. Encapsulation | 7. Encapsulation | 10. Joints à séchage en place | 13. Agent d'encapsulation globulaire |
| 4. Sertissage | | | |

Avantages pour l'environnement des matériaux photopolymérisables Dymax

Nous considérons chez Dymax que des produits sûrs et écologiques profitent à nos clients, à l'environnement et à nous-mêmes. Les produits que nous avons créés ont un impact écologique minimal. Cela suppose notamment :

- Des matériaux sans solvant
- Des matériaux sans halogènes
- La conformité à la directive RoHS
- La conformité au règlement REACH (substances extrêmement préoccupantes – SVHC)
- Des matériaux écologiques à un seul composant

Les revêtements conformes, les agents d'encapsulation et les adhésifs sans halogène de Dymax sont documentés par un laboratoire indépendant pour respecter ou dépasser les normes énoncées dans la directive CEI 61249-2-21. Selon cette directive internationale sans halogène se définit par < 900 ppm pour le chlore, < 900 ppm pour le brome et < 1 500 ppm pour les deux combinés. La méthode d'essai actuellement utilisée pour la certification est la norme BS EN 14582: 2007.



Revêtements conformes

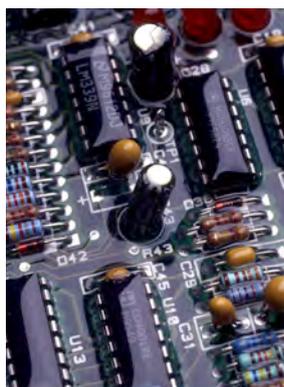
Une protection fiable des cartes en quelques secondes



Revêtements fluorescents bleus



Revêtements fluorescents Ultra-Red®



Revêtements avec polymérisation secondaire à la chaleur ou à l'humidité

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sans solvant
- Adhérence aux substrats des circuits imprimés flexibles (FPC)
- Polymérisation sous UV sèche au toucher en quelques secondes
- Faible contrainte sous les variations thermiques cycliques
- Excellente résistance environnementale
- Revêtements rigides et souples disponibles
- Teintes noires disponibles
- Diverses viscosités disponibles

Numéro de produit*	Description	Viscosité nominale (cP)	Dureté au duromètre	Module d'élasticité, MPa [psi]	Puissance diélectrique, Volts/mm	Approbations	Sans halogènes ?
9-20351-UR	<ul style="list-style-type: none"> Application facile une couche sur conducteurs à haut-profil et grands composants sans écoulement sur les zones ombrées Polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées 	13 500	D60	30,3 [4 400]	500	—	
9-20557	<ul style="list-style-type: none"> Viscosité moyenne pour le mouillage des composants Faible module pour une meilleure résistance aux variations thermiques cycliques Polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées 	2 300	D60	37,9 [5 500]	>1 500	Homologué MIL-I-46058 Approuvé IPC-CC-830 UL 94V-1	
9-20557-LV	<ul style="list-style-type: none"> Faible viscosité pour revêtement fin Faible module pour une meilleure résistance aux variations thermiques cycliques Polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées 	850	D70	310 [45 000]	>1 500	Homologué MIL-I-46058C Approuvé IPC-CC-830	
984-LVUF	<ul style="list-style-type: none"> Rigide pour une résistance élevée aux produits chimiques et à l'abrasion Polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées 	160	D85	724 [105 100]	1 800	Homologué MIL-I-46058 Approuvé IPC-CC-830 UL 94V-0	
987	<ul style="list-style-type: none"> Résistance élevée aux produits chimiques et à l'abrasion Polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées 	150	D85	900 [130 000]	>1 500	Homologué MIL-I-46058 Approuvé IPC-CC-830	
9451	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement en noir véritable idéal pour couvrir les informations sensibles Polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées Revêtement optimisé pour une seule couche 	6 000	—	717 [104 000]	1 200	UL 94V-0	
9452-FC	<ul style="list-style-type: none"> Viscosité extrêmement basse pour applications de revêtement par film ou arrosage Très bonne résistance aux chocs thermiques Polymérisable sous DEL Polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées Fluorescence bleue 	20	D60	1 137 [165 000]	1 000	UL 94V-0**	
9481-E	<ul style="list-style-type: none"> Polymérisation secondaire par l'humidité à température ambiante pour les zones ombrées Résistance maximale aux produits chimiques et à l'abrasion Faible viscosité pour revêtement fin 	125	D75	150 [21 800]	>1 500	Homologué MIL-I-46058 Approuvé IPC-CC-830 UL 94V-0 UL 746E	
9482	<ul style="list-style-type: none"> Polymérisation secondaire par l'humidité à température ambiante pour les zones ombrées Retouchabilité supérieure Résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques 	1 100	D70	275 [40 000]	1 100	Homologué MIL-I-46058 Approuvé IPC-CC-830 UL 94V-0 UL 746E	

* D'autres degrés sont disponibles pour des applications spécifiques requérant d'autres propriétés physiques que les produits standard de la présente liste.

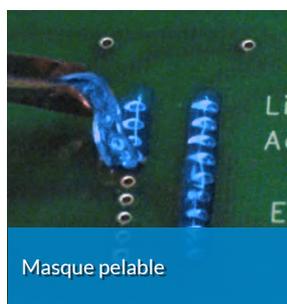
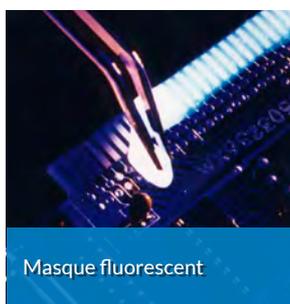
** Essais accomplis en interne chez Dymax.

Masques pelables SpeedMask®

Numéro de produit*	Description et applications	Profondeur de polymérisation,** mm [po]	Dureté au duromètre	Vitesse de polymérisation*, sec.	Viscosité, cP	Sans halogènes ?
9-20479-B-REV-A	<ul style="list-style-type: none"> Résistant aux soudures à la vague Couleur bleue pour une inspection visuelle facile Haute tixotropie pour une distribution automatisée ou manuelle 	4,90 [0,19]	A70	1	150 000	
9-318-F	<ul style="list-style-type: none"> Résistant aux soudures à la vague Fluorescence bleue pour une inspection facile Polymérisation très rapide 	6,40 [0,25]	A55	<4	50 000	
9-7001	<ul style="list-style-type: none"> Résistant aux soudures à la vague Couleur rose visible à l'état non-polymérisé Contraction plus faible 	8,36 [0,33]	A70	1	40 000	

* La vitesse de polymérisation dépend de l'intensité et de la distance de la source lumineuse. La vitesse de polymérisation a été mesurée avec une intensité de 175 mW/cm².

** Polymérisation en 5 secondes



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Solides 100 %
- Grades fluorescents et bleus
- Polymérisation par UV/lumière visible en quelques secondes
- Prêt à l'emploi – pas de mélange
- Pas de contamination ionique

Adhésifs pour fixation de filage

La technologie de photopolymérisation offre des coûts moins élevés et une productivité accrue

Numéro de produit*	Description	Viscosité nominale, cP	Dureté au duromètre	Allongement à la rupture, MPa [psi]	Sans halogènes ?
9-911-REV-B	<ul style="list-style-type: none"> Polymérisation à la demande pour positionnement optimal Polymérisation en quelques secondes des zones exposées pour une robustesse immédiate 	25 000	D80	24 [3 500]	



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Polymérisation instantanée sous UV
- Additif fluorescent pour contrôle qualité sur chaîne
- Prêt à l'emploi – pas de mélange
- Excellente adhérence aux masques de soudure et aux fils
- Sans solvant
- Résistance aux chocs thermiques, aux solvants et à l'humidité
- Durée de vie en pot illimitée

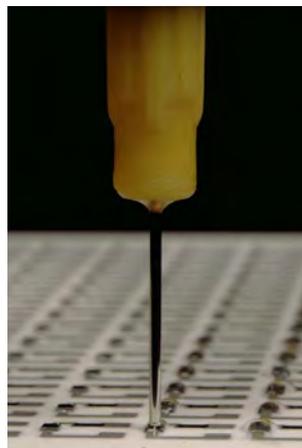
Agent d'encapsulation de puces et microsoudures

Protection supérieure sur les plate-formes flexibles et rigides

Numéro de produit*	Description	Applications	Dureté au duromètre	Viscosité nominale, cP	Allongement à la rupture, %	Module d'élasticité, MPa [psi]	Sans halogènes ?
9001-E-V3.1	<ul style="list-style-type: none"> Polymérisation sous UV ou lumière visible avec polymérisation secondaire à la chaleur pour les zones d'ombre Disponible en plusieurs viscosités pour un arrosage et une couverture optimum Faible module pour le collage de fils 	<ul style="list-style-type: none"> Puces-sur-carte Puces sur substrat flexible Puces sur verre Collage de fils Encapsulation de puces nues 	D45	4 500	500	17 [2 500]	
9001-E-V3.5				17 000			
9008	<ul style="list-style-type: none"> Flexible Liaisons hautement résistantes à l'humidité sur diverses surfaces telles que le polyimide, le DAP, le verre, l'époxy, le métal et PET Haute adhérence, même à -40 °C 	<ul style="list-style-type: none"> Puces sur substrat flexible Collage sur circuit imprimé flexible et fixation sur PCB et verre 	A85	4 500	300	45 [6 500]	
9037-F	<ul style="list-style-type: none"> Polymérisation sous UV ou lumière visible avec polymérisation secondaire à la chaleur pour les zones d'ombre Résistance thermique et à l'humidité Fluorescence bleue 	<ul style="list-style-type: none"> Puces-sur-carte Puces sur substrat flexible Puces sur verre Collage de fils 	D42	51 234	173	10,7 [1 554]	
9101	<ul style="list-style-type: none"> Polymérisation sous UV ou lumière visible avec polymérisation secondaire à l'humidité pour les zones d'ombre Flexible Résistance thermique et à l'humidité 	<ul style="list-style-type: none"> Puces-sur-carte Puces sur substrat flexible Puces sur verre Collage de fils 	D30-D50	7 000	38	17,5 [2 550]	
9102				17 000	34	18,4 [2 670]	
9103				25 000	36	17,6 [2 560]	



Polymérisation secondaire à la chaleur ou à l'humidité



Agents d'encapsulation de puces



Agents d'encapsulation pour circuits imprimés flexibles/ Collage de fils



Agents d'encapsulation noirs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 100 % sans solvant
- Faible contrainte sous les variations thermiques cycliques
- Polymérisation instantanée sous UV ou lumière visible
- Isolation électrique
- Pureté ionique élevée
- Stockage à température ambiante
- Adhérence tenace aux substrats de circuits imprimés flexibles (polyimide et PET)
- Résistance aux chocs thermiques et à l'humidité

Collage et stratification d'affichages optiques

Numéro de produit*	Description	Applications	Contraction volumétrique, %	Viscosité nominale, cP	Sans halogènes ?
9701	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente retouchabilité • Bonne résistance aux chocs thermiques • Faible contraction • Résistance au jaunissement 	Stratification d'affichages optiques et collage d'écrans tactiles	4,9	200	
9702	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente retouchabilité • Bonne résistance aux chocs thermiques • Faible contraction • Résistance au jaunissement 	Stratification d'affichages optiques et collage d'écrans tactiles	4,2	950	
9703	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente retouchabilité • Bonne résistance aux chocs thermiques • Faible contraction • Résistance au jaunissement 	Stratification d'affichages optiques et collage d'écrans tactiles	4,2	30 000	



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Prêt à l'emploi, aucun mélange n'est nécessaire
- Flexible
- Polymérisation rapide
- Colle différents substrats
- Résistant au jaunissement
- Grande clarté optique

Adhésifs d'interface thermique

Transfert thermique efficace entre dissipateurs de chaleur et électronique

Numéro de produit*	Description	Application	Conductivité thermique	Viscosité nominale, cP	Sans halogènes ?
9-20801	<ul style="list-style-type: none"> • Photopolymérisation en quelques secondes • Activateur ou polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées* • Hautement thixotropique pour placement optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Montage de dissipateurs de chaleur sur PCB • Dissipation de chaleur de DEL 	0,9 W/m ² *K	110 000	

*Le Dymax [501-E](#) est l'activateur recommandé pour les zones ombrées



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fixation en quelques secondes avec exposition légère
- Faible contrainte pour CTE dépareillé
- Polymérisation des zones ombrées par activateur ou à la chaleur
- Stockage et séchage à température ambiante
- Collages haute résistance

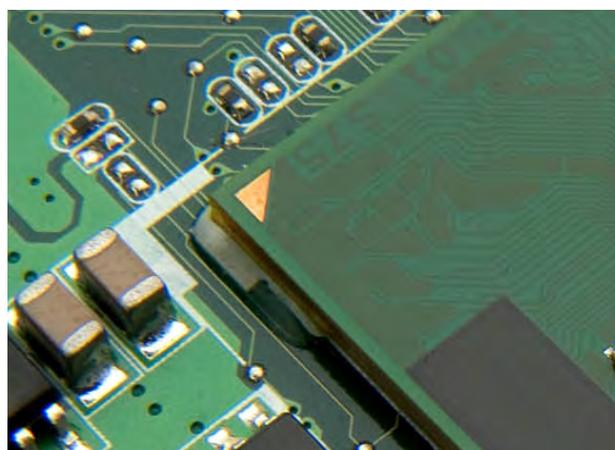
Matériaux de renforcement ou de collage des bords pour BGA et VGA

La technologie de photopolymérisation offre des coûts moins élevés et une productivité accrue

Numéro de produit*	Description et applications	Viscosité nominale, cP	Dureté au duromètre	Allongement à la rupture, MPa [psi]	Profondeur de polymérisation, mm [po]	Sans halogènes ?
9309-SC	<ul style="list-style-type: none"> Hautement thixotropique Préparation selon la technologie See-Cure pour confirmation visuelle simple du durcissement complet 	45 000	D57	22 [3 000]	6,5 [0,26]	
9422-SC	<ul style="list-style-type: none"> Hautement thixotropique pour un placement et un mouillage optimaux des composants Préparation selon la technologie See-Cure pour confirmation visuelle simple du durcissement complet 	38 000	D50	16 [2 300]	6,5 [0,26]	



Renforcement



Composant sans plomb
Collage des bords/collage des coins

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Distribution et polymérisation rapides
- Conserve sa forme après distribution
- Inspection visuelle simple avec la technologie See-Cure
- Solidité de collage améliorée pour test de puce et de force
- Retouches faciles
- Contraintes réduites sur les interconnexions en cas de poussée, de traction, de choc, de chute, et de vibrations
- Forme de goutte conçue pour mouiller à la fois la surface de la carte et le bord du composant sans écoulement sur la zone ombrée
- Application par jet

Matériaux d'enrobage et de scellage

Pour un enrobage peu profond en 10 à 30 secondes max. – Adhérence supérieure au substrat

Numéro de produit*	Description et applications	Substrats recommandés	Polymérisation sous UV* Vitesse (sec)/ Profondeur (mm) [po]	Dureté au duromètre	Viscosité nominale, cP	Sans halogènes ?
921-T	<ul style="list-style-type: none"> Connecteurs, interrupteurs thermiques Protection contre les modifications Liaisons translucides à adhérence élevée 	ABS, nylon chargé, métaux, verre	30/6,4 [0,25]	D75	3 500	
921-VT					11 000	
921-GEL					25 000	
9001-E V3.1	<ul style="list-style-type: none"> Capteurs Flexible Excellente adhérence aux plastiques techniques 	ABS, PC, PVC, FR-4, métaux	15/6,4 [0,25]	D45	4 500	
9001-E V3.5					17 000	
9037-F	<ul style="list-style-type: none"> Polymérisation thermique secondaire pour les zones ombrées Fluorescence bleue Flexible, bonne résistance thermique et à l'humidité 	FR-4, verre, Kapton	À déterminer	D42	51 234	

*La vitesse de la polymérisation sous UV dépend de l'intensité qui atteint la surface de la résine. La vitesse de polymérisation a été mesurée avec une intensité de 175 mW/cm².



Enrobage de câble



Enrobage de couche profonde

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Polymérisation complète par UV/lumière visible en quelques secondes
- Sans solvant
- Adhérence élevée au substrat
- Disponibilité de produits flexibles et rigides

Encapsulation sous LED

Fixation, enrobage et scellage en quelques secondes

Numéro de produit*	Description	Applications	Contraction linéaire	Viscosité nominale, cP	Sans halogènes ?
LIGHT-CAP® 9622	<ul style="list-style-type: none"> Polymérisation par UV/lumière visible en quelques secondes Aucun mélange requis Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C Résistance à l'exposition prolongée aux UV Transmission lumineuse élevée Duromètre entre le silicone et l'époxy 	<ul style="list-style-type: none"> Moulage instantané de DEL Formation rapide de lentilles optiques de protection 	0,79 %	12 000	



Affichage DEL d'aéroport



Éclairage DEL

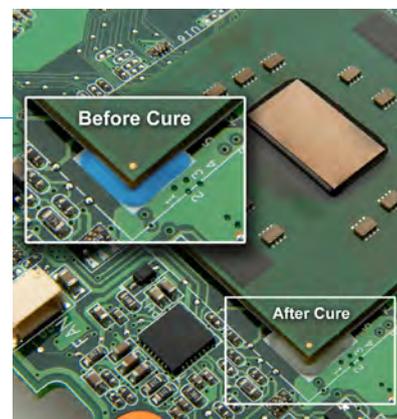
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Prêt à l'emploi – aucun mélange n'est nécessaire
- Améliore la transmission lumineuse
- Polymérisation rapide
- Sans solvant
- Résistance au jaunissement induit par la chaleur
- Transparence optique

Technologies d'adhésifs Dymax

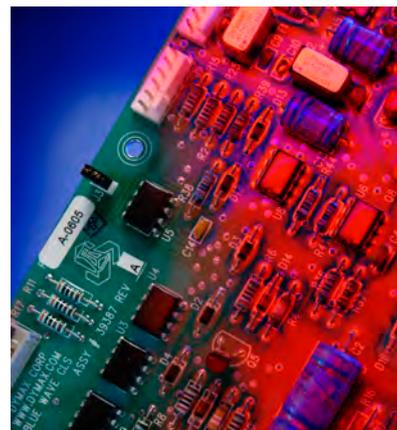
TECHNOLOGIE SEE-CURE

Les adhésifs polymérisable à la lumière préparés selon la [technologie See-Cure](#) brevetée par Dymax offrent une validation intégrée de la polymérisation qui facilite la confirmation de la polymérisation pour les opérateurs ou le simple matériel d'inspection automatisée, sans nécessité d'investir dans du matériel spécialisé supplémentaire. La technologie See-Cure modifie volontairement la couleur de l'adhésif une fois polymérisé et apporte un facteur visuel de sécurité au processus d'assemblage.



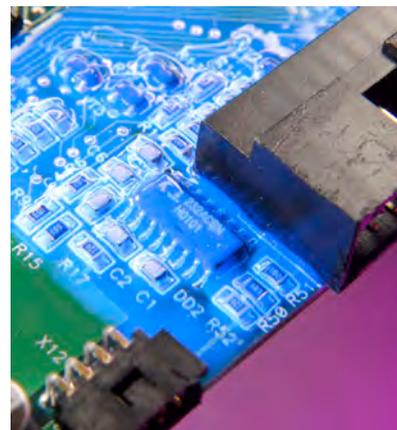
TECHNOLOGIE DE FLUORESCENCE ULTRA-RED®

La [Technologie de fluorescence Ultra-Red®](#) brevetée par Dymax améliore les procédés d'inspection des liaisons, et d'authentification de produit. Les adhésifs préparés avec Ultra-Red® sont transparents jusqu'à ce qu'ils soient exposés à des rayons UV de faible intensité, qui les rendent rouge vif fluorescent. Ceci est particulièrement efficace pendant le liage de plastiques qui passent naturellement au bleu fluorescent comme le PVC et le PET. La technologie Ultra-Red® produit également une signature spectrale unique qui peut être utilisée par les fabricants pour l'authentification de produits.



TECHNOLOGIE MULTI-CURE® DE POLYMERISATION PAR LA LUMIERE OU LA CHALEUR

Les adhésifs Multi-Cure® associent la polymérisation ultra-rapide des UV ou de la lumière visible aux mécanismes de polymérisation secondaire qui améliorent celle-ci. Les mécanismes de polymérisation secondaire, qui comprennent la polymérisation thermique (chaleur) ou par activateur, sont utiles lorsque la lumière ne peut atteindre qu'une partie de la liaison, ou lorsqu'on fixe une partie avant la polymérisation thermique pour simplifier la manipulation et le transport pendant la fabrication.



TECHNOLOGIE DUAL-CURE DE SÉCHAGE À L'HUMIDITÉ ET À LA LUMIÈRE

[Les revêtements Dual-Cure](#) sont formulés pour assurer un durcissement complet lorsque les zones ombrées sur les cartes de circuits imprimés à haute densité constituent un problème. Jusqu'à présent, on traitait les zones inaccessibles à la lumière au moyen d'un revêtement sélectif – éliminant le besoin de séchage dans les zones ombrées – ou par un procédé de polymérisation secondaire à chaud. Les zones ombrées sèchent au fil du temps grâce à l'humidité, éliminant le besoin d'une seconde phase de traitement ou tout souci de dégradation de la durée de vie du composant en raison de l'exposition aux températures.



ADHÉSIFS ET REVÊTEMENTS POLYMERISABLES SOUS DEL

Dymax propose des [adhésifs et des revêtements polymérisables sous DEL](#) spécialement préparés pour servir avec les systèmes Dymax de polymérisation sous DEL, UV ou lumière visible. Ces adhésifs permettent une vitesse de polymérisation allant de rapide à ultra-rapide adaptée aux nécessités particulières d'assemblage électronique.

Matériel de distribution et de polymérisation

pour applications électroniques et photoniques

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

Dymax a mis au point des [systèmes de distribution](#) de haute qualité et éprouvés convenant à de nombreuses applications de distribution d'adhésifs et de fluides. Ces systèmes comprennent diverses vannes de distribution automatique et manuelle, vannes et pistolets de pulvérisation, contrôleurs, réservoirs de matériaux et composants connexes s'intégrant de façon transparente au processus de montage. Ils permettent la distribution précise et constante d'une gamme de fluides de viscosité faible à élevée. Des systèmes de distribution à contrôle réglable d'aspiration inverse et des vannes permettant une distribution sans contamination sont disponibles.



DISTRIBUTEUR À SERINGUE NUMÉRIQUE SD-100

- Contrôle précis de la distribution de matériaux de viscosité faible à élevée.
- Idéal pour l'utilisation au poste d'un opérateur ou l'intégration à un processus automatisé.



SYSTÈME DE DISTRIBUTION PAR VANNE À AIGUILLE MANUELLE MODÈLE 400

- Conçu pour la distribution très précise de points ou de fines gouttes de matériaux de viscosité faible à élevée.

SYSTÈMES DE PHOTOPOLYMÉRISATION

Dymax conçoit et fabrique une vaste gamme de [matériel de polymérisation](#) dont des lampes spot, des lampes de projection et des systèmes de convoyage, ainsi que des radiomètres et d'autres accessoires. Les systèmes Dymax sont optimisés pour fonctionner avec des adhésifs photopolymérisables qui rendent le procédé plus efficace en visant la polymérisation rapide de surface, de profondeur et la vitesse de polymérisation, tout en distribuant la lumière de façon rapide et économique. Le matériel marqué CE est disponible.

LAMPE SPOT

Les lampes spot offrent de multiples façons d'éclairer un point très précis. Elles peuvent être utilisées manuellement par un opérateur ou intégrées à une chaîne de montage automatisée à grande vitesse. Dymax propose des lampes multi-spectre à ampoules à vapeur de mercure haute pression ainsi que des lampes spot à diode électroluminescente, utilisant une variété de DEL montées en surface au lieu des ampoules traditionnelles halogènes ou au mercure.



LAMPE SPOT DE PHOTOPOLYMÉRISATION BLUEWAVE® 200 VERSION 3.0

- Idéal pour le traitement rapide de petites surfaces de polymérisation
- Adapté aux procédés manuels ou automatisés

SYSTÈME DE PHOTOPOLYMÉRISATION BLUEWAVE MX-150® LED

- Conception à émetteur pour une configuration flexible et une intensité constante
- Idéal pour les revêtements de polymérisation par spot à froid
- Interface PLC s'intégrant facilement aux systèmes automatisés



SYSTÈME DE PHOTOPOLYMÉRISATION BLUEWAVE® QX4® DEL

- Un régulateur contrôle jusqu'à quatre têtes DEL
- Les têtes DEL sont disponibles en longueurs d'onde de 365, 385, et 405 nm
- Interface PLC s'intégrant facilement aux systèmes automatisés

SYSTÈMES DE CONVOYAGE

Un [système de convoyage](#) se compose d'une bande mobile qui traverse un tunnel de polymérisation dont les parois supérieure ou latérales sont dotées de lampes multi-spectre pour une polymérisation rapide des pièces. Ces systèmes de convoyage sont conçus pour une réticulation consistante, rapide et sûre. On peut les équiper de batteries d'ampoules halogènes standard (UV longues ondes), au mercure (UV ondes courtes), de lumière visible ou de DEL. La constance de la vitesse de chaîne constante, de la hauteur des lampes et de l'intensité permettent un processus de polymérisation régulier pour un débit élevé.



SYSTÈMES DE CONVOYAGE DE PHOTOPOLYMÉRISATION UVC-8

- Idéal pour les environnements de production et de laboratoire
- Haute intensité



SYSTÈMES DE CONVOYAGE DE PHOTOPOLYMÉRISATION UVC-5

- Idéal pour la polymérisation de petites pièces
- Intensité moyenne

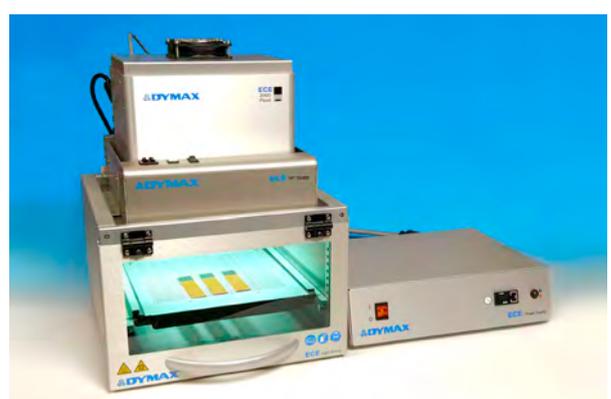
LAMPES DE PROJECTION

Les [systèmes statiques de lampes de projection](#) conviennent à la polymérisation de zone ou d'assemblages multiples. Dymax propose des modèles à base d'UV ou de lumière visible multi-spectre à haute intensité et des modèles à base de diodes électroluminescentes pour une polymérisation rapide. Les lampes de projection Dymax s'intègrent facilement aux procédés de fabrication existants par le montage de lampes au-dessus des chaînes d'assemblage à grande vitesse pour une polymérisation rapide. Des ensembles d'obturateurs, des supports de montage et des protections sont disponibles afin de créer un système de polymérisation personnalisé.



SYSTÈMES DE LAMPES DE PROJECTION ECE 5000

- Le plus apprécié et le plus polyvalent
- Idéal pour les applications d'enrobage, de scellage, et d'encapsulation



SYSTÈMES DE LAMPES DE PROJECTION ECE 2000

- La lampe de projection offrant la plus vaste zone de polymérisation
- Idéal pour les applications DEL et de masquage

RADIOMÈTRES

La mesure de l'intensité de la lampe et du dosage est déterminante pour la mise en place de la technologie de polymérisation. Les radiomètres [Dymax](#) permettent à l'opérateur de surveiller et de documenter le processus de photopolymérisation.





© 2003-2017 Dymax Corporation. Tous les droits sont réservés. Toutes les marques de commerce figurant dans ce guide, sauf mention contraire, sont la propriété de Dymax Corporation, États-Unis d'Amérique ou utilisées sous licence.

Les données contenues dans ce bulletin sont de nature générale et basées sur des conditions d'essai en laboratoire. Dymax Europe GmbH ne garantit pas les données contenues dans ce bulletin. Toute garantie applicable aux produits, leur application et leur utilisation est strictement limitée à celle contenue dans les Conditions Générales de Vente de Dymax Europe GmbH publiées sur notre site interne www.dymax.com/de/bdf/dymax_europe_general_terms_and_conditions_of_sale.pdf. Dymax Europe GmbH n'assume aucune responsabilité pour les résultats d'essais ou de performances obtenus par les utilisateurs. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude quant à l'application et aux finalités du produit ainsi que l'aptitude à l'emploi dans les appareils et méthodes de fabrication prévus par l'utilisateur. L'utilisateur doit adopter de telles précautions et utiliser les lignes directrices qui peuvent être raisonnablement recommandées ou nécessaires pour la protection des biens et des personnes. Rien dans le présent bulletin n'agira comme une déclaration selon laquelle l'utilisation ou l'application du produit ne contreviendrait pas à un brevet appartenant à quelqu'un d'autre que Dymax Corporation ou agira comme une subvention de licence sous un brevet de Dymax Corporation. Dymax Europe GmbH recommande à chaque utilisateur de tester adéquatement l'utilisation et l'emploi proposés des produits avant une utilisation répétitive réelle, en utilisant les données contenues dans ce bulletin comme guide général.

LIT019EU 8-8-2017

DYMAX CORPORATION

+1 860 482-1010 | info@dymax.com | www.dymax.com

DYMAX EUROPE GMBH

+49 611 962-7900 | info_de@dymax.com | www.dymax.de

DYMAX ENGINEERING ADHESIVES IRELAND LTD.

+353 21 237-3016 | info_ie@dymax.com | www.dymax.ie

DYMAX OLIGOMERS & COATINGS

+1 860 626-7006 | info_oc@dymax.com | www.dymax-oc.com

DYMAX UV ADHESIVES & EQUIPMENT (SHANGHAI) CO. LTD.

+86 21 37285759 | dymaxasia@dymax.com | www.dymax.com.cn

DYMAX UV ADHESIVES & EQUIPMENT (SHENZHEN) CO. LTD.

+86 755 83485759 | dymaxasia@dymax.com | www.dymax.com.cn

DYMAX ASIA (HK) LIMITED

+852 2460-7038 | dymaxasia@dymax.com | www.dymax.com.cn

DYMAX ASIA PACIFIC PTE. LTD.

+65 6752-2887 | info_ap@dymax.com | www.dymax-ap.com

DYMAX KOREA LLC

+82 2 784-3434 | info_kr@dymax.com | www.dymax.com/kr